

参加募集

エントリー締め切り 2008年8月1日

プログラム締め切り 2008年9月26日

外観検査アルゴリズムコンテスト2008

<http://www.tc-iaip.org/alcon/>

主催 (社)精密工学会 画像応用技術専門委員会

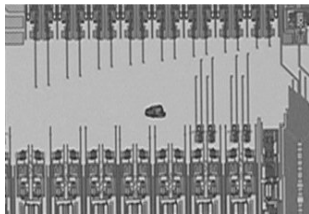
趣旨 画像応用技術専門委員会では、画像を用いた外観検査技術の発展を図るため、研究者・技術者が共通で使える外観検査画像データベースの構築を進めつつ、その一環として外観検査アルゴリズムコンテストを2001年より実施しております。お陰様で実際の製造現場で生じる画像をそのまま使用した他に例を見ないユニークなコンテストとして、広く認知されるようになって来ました。第8回目の今年は、産業界でのニーズも非常に高い半導体パターン上の欠陥を種類ごとに分類するアルゴリズムのコンテストを実施します。優秀作品は12月に開催されるビジョン技術の実利用ワークショップ (ViEW2008) で表彰致します。検査画像と詳しい応募要領、画像、参加方法はホームページ (<http://www.tc-iaip.org/alcon/>) で公開致します。また今回より匿名による応募もお認めすることになりました。これまで諸事情で応募を躊躇されていた方は是非、ご活用下さい。皆様の挑戦をお待ち致しております。

課題 「半導体パターン上の欠陥分類」

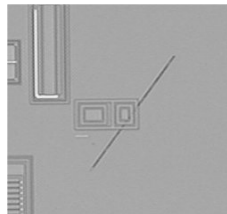
検査対象：パターン付きウエハ

検査目的：画像中央に位置する欠陥を、予め決められた数種類のカテゴリーに分類

評価項目：欠陥分類の正解率および処理時間



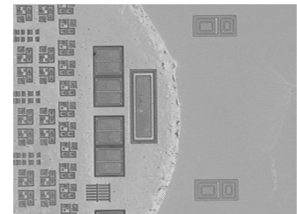
異物



傷



パターン欠陥A



パターン欠陥B

エントリー 締め切り 2008年8月1日 (金)

ホームページの申し込み画面、もしくは電子メール、FAXでお申し込み下さい。

〒182-0026 東京都調布市小島町1-11-6 エンケ102(株)キャンパスクリエイト内
画像応用技術専門委員会「外観検査アルゴリズムコンテスト」事務局

TEL: 080-1076-0019, FAX: 020-4662-8246, E-mail: gazoh@campuscreate.com

プログラム 締め切り 2008年9月26日 (金)

ホームページの申し込み画面もしくは電子メール添付で事務局にお送り下さい。

ただし、プログラム実行ファイル、動作指示書、予稿をお付け下さい。

結果発表 ビジョン技術の実利用ワークショップ (ViEW2008) (2008年12月) およびホームページ
最優秀賞(1名)、優秀賞(2名)、学生奨励賞(1名)、特別賞(1名)の予定

実行委員 寺田賢治 (委員長：徳島大)、北川克一 (幹事：東レエンジニアリング)、大橋剛介 (幹事：静岡大)、青木義満 (芝浦工大)、伊藤誠也 (日立製作所)、大西浩之 (大日本スクリーン製造)、藤原伸行 (明電舎)、加藤邦人 (岐阜大)、橋本学 (三菱電機)、林純一郎 (香川大)、広瀬修 (住友化学)、堀修 (東芝)、脇谷康一 (松下電器)
秦清治 (香川大：顧問)、浅野敏郎 (広島工大：テクニカルアドバイザー)、梅田和昇 (中央大：テクニカルアドバイザー)、糊澤信 (旭硝子：テクニカルアドバイザー)